



- ☑ 24,000CPH(相当于0.15秒/CHIP:(最佳条件)的高速贴装能力
- ☑ 可对应0402 CHIP~□45mm元件、长接头的广范围元件
- ☑ 全部时间,贴装绝对精度±50 μ m(CHIP)、±30 μ m(QFP)
- ☑ 对象元件15mm对应高度
- ☑ 长尺寸对应基板(~L510mm)

基本规格

机型	YG100RA(FNC型)/YG100RB(SF型) 型号:KHW-000
对象基板	L50×W50mm ~L510×W460mm (注1)(注2)
贴装效率 (最適条件)	24,000CPH/CHIP(相当于0.15秒/CHIP)
贴装精度 (本公司标准元件)	绝对精度($\mu + 3\sigma$): ±0.05mm/CHIP, ±0.05mm/QFP 重复精度(3σ): ±0.03mm/CHIP, ±0.03mm/QFP
对象元件	0402(mm系名称)~□55mm元件、SOP/SOJ、QFP、接头、PLCC、CSP/BGA、长接头(注3)(注4)(注5) 对象元件高度15mm以下(注6)
元件种类	96种(最大、换算成8mm卷带)(注1)
电源规格	三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V ±10%50/60 Hz
供气源	0.55MPa以上、清洁干燥状态
外形尺寸 (注7)	L1,650×W1,562(盖板端)×H1,470mm(盖板上方) L1,650×W1,615(整批更换台车导轨端)×H1,470mm(盖板上方)
主体重量	约1,630kg:(仅主体)

(注1) 根据与sATS/wATS/dYTF组装的机械配置而有所不同。

(注2) 对应长尺寸基板或二段(上推)顶板规格时,需进行协商。

(注3) □31型多功能摄影机时,为W31×L100mm以下的接头。

(注4) □45型多功能摄影机时,为W45×L100mm以下的接头。

(注5) 大型元件及长接头时,关于偏心偏移量及旋转角度,需进行协商。

(注6) YG100RA时,搬入前基板上方高度须在4mm以下。

(注7) 不包括突起部分的尺寸。